財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：黃苡慈
電話：03-5914364
E-mail：yt.huang@itri.org.tw

1110021983014

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 111. 10. 25 文
檔號：111570

241 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 111 年 10 月 24 日
發文字號：工研轉字第 1110021983 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：本院擬舉辦「111 年度工研院南分院智慧聯網技術及雷射創新應用等專利讓與案」公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「111 年度工研院南分院智慧聯網技術及雷射創新應用等專利讓與案」（53 案 90 件專利）之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。

二、「讓與標的」共分為 4 個類別：

（一）智慧聯網技術：35 案 59 件。

（二）雷射創新應用：10 案 12 件。

（三）積層製造技術：6 案 14 件。

（四）軟性製造技術：2 案 5 件。

三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案截標日為民國（下同）111 年 11 月 14 日，開標包含初審（111 年 11 月 15 日）及複審（決標日為 111 年 11 月 25 日），投標廠商於通過初審後，始進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

（二）詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考工研院研發成果公告網站：

（https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1163724603633140525）

（三）公開說明會資訊：

1.舉辦時間：111 年 11 月 4 日 14 時舉辦。

2.舉辦地點：採取線上方式辦理。

3.報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 11 月 3 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「111 年度工研院南分院智慧聯網技術及雷射創新應用等專利讓與案公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 11 月 3 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心黃小姐

電話：（03）591-4364

傳真：（03）582-0466

電子信箱：yt.huang@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

111 年度工研院南分院
智慧聯網技術及雷射創新應用等專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 53 案 90 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

（一）智慧聯網技術 35 案 59 件；

（二）雷射創新應用 10 案 12 件；

（三）積層製造技術 6 案 14 件；

（四）軟性製造技術 2 案 5 件。

「讓與標的」並無共有專利，「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）111 年 11 月 4 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 11 月 3 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「111 年度工研院南分院智慧聯網技術及雷射創新應用等專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 11 月 3 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 111 年 11 月 14 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

（一）本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1.（密封）價格封。

2.押標金。

3.公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）。

4.近兩年財報資料。

5.公司基本資料暨運用規劃說明表。

6.商業營運計畫書一式 7 份。（若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。）

（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「111 年度工研院南分院智慧聯網技術及雷射創新應用等專利讓與案投標」，於截標日 111 年 11 月 14 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 黃小姐收。

（二）廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額。

（三）商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1.公司背景／關係企業／合作夥伴簡介（20%）

2.公司財務狀況（20%）

3.公司營運／研發能力（20%）

4.「讓與標的」運用規劃（30%）

5.國內產業效益（10%）

（如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等）

（四）投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。（「讓與標的」以同一發明為一案。）

（五）本讓與案不得共同投標或重複投標。

（六）投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

（七）投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

（一）押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）。

（二）押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明

禁止背書轉讓。

（三）得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

（一）投標時間截止後之投標。

（二）開標前業已公告停止本讓與案交易程序。

（三）投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。

（四）投標單附加任何成交條件者。

（五）投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。

（六）投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標時未能補足者，其投標為無效。

（七）投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。

（八）投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

（一）分為初審（開標日為 111 年 11 月 15 日）及複審（決標日為 111 年 11 月 25 日），投標廠商於通過初審後，始能進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

（二）得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

（三）初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書進行書面審查及確認。

（四）投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書進行複審，投標廠商於決標日應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

（五）投標廠商若有境外實施需求，除於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額，並於複審時報告說明。

（六）複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商底價單，將以投標廠商金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商可優先有一次加價機會，若此加價仍無超過底價，之後則由所有投標廠商同時議價，所有投標廠商間的同時比增價格以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商總評比分數均超過及格分，投標金額亦均超過底價且相同，得提供投標廠商議價機會，並以高價者決標。比增價格以三次為限，若比增三次後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。（議價時，若非投標廠商負

責人出席，須填妥並提供委託代理授權書）

（七）決標時將請律師到場監標。

（八）決標後將個別通知投標廠商決標結果（不公告得標廠商）。

（九）對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

（一）得標廠商應於接獲得標通知起30個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。

（二）得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

（三）得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

（四）遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。

（五）得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。

（六）得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。

（七）反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。

（八）得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：

1.工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；

2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；

3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。

（九）得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

（十）「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

（十一）「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

（十三）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與後手之讓與契約，否則即視為將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」。

（十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

（十五）基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

（十六）得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或

股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

（十七）得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 黃小姐。

電話：（03）591-4364，傳真：（03）582-0466。

電子信箱：yt.huang@itri.org.tw。

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

附件：專利清單

（一）智慧聯網技術 35 案 59 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
1	1	P27000010	P27000010TW	電力線網路控制系統與方法	中華民國	獲證	I437835	I437835	20140511	20310807	
	2	P27000010	P27000010US	電力線網路控制系統與方法	美國	獲證	8649328	8649328	20140211	20320515	
2	3	P27000032	P27000032TW	肌能參數感測器	中華民國	獲證	I446896	I446896	20140801	20311222	
3	4	P27000040	P27000040CN	智能型插座、插頭及轉接器	中國大陸	獲證	CN103178374	ZL201210031003.2	20160803	20320205	
	5	P27000040	P27000040JP	智慧型插頭、插座及轉接器	日本	獲證	5701282	5701282	20150227	20321217	
	6	P27000040	P27000040TW	智慧型插頭、插座及轉接器	中華民國	獲證	I448022	I448022	20140801	20311221	
	7	P27000040	P27000040US	智慧型插頭、插座及轉接器	美國	獲證	9231351	9231351	20160105	20340109	
4	8	P27000041	P27000041TW	主控裝置、被控裝置、及其網路通訊方法	中華民國	獲證	I484789	I484789	20150511	20311229	
	9	P27000041	P27000041US	主控裝置、被控裝置、及其網路通訊方法	美國	獲證	9722875	9722875	20170801	20341117	
5	10	P27000045	P27000045TW	分散式資源管理系統及其分散式資源管理方法	中華民國	獲證	I454949	I454949	20141001	20311225	
	11	P27000045	P27000045US	分散式資源管理系統及其分散式資源管理方法	美國	獲證	8819239	8819239	20140826	20321218	
6	12	P27000058	P27000058TW	生物電訊號感測電路及方法	中華民國	獲證	I421509	I421509	20140101	20311227	
7	13	P27000068	P27000068TW	人體下肢力學行為評估系統與方法	中華民國	獲證	I438018	I438018	20140521	20311222	
	14	P27000068	P27000068US	人體下肢力學行為評估系統與方法	美國	獲證	9521964	9521964	20161220	20341127	
8	15	P27010018	P27010018TW	一種具高度適應性交談管理機制之遠端管理系統	中華民國	獲證	I505682	I505682	20151021	20321031	V
	16	P27010018	P27010018US	一種具高度適應性交談管理機制之遠端管理系統	美國	獲證	8938495	8938495	20150120	20331002	V
9	17	P27010024	P27010024TW	服務管理方法與系統	中華民國	獲證	I554092	I554092	20161011	20321216	
10	18	P27010033	P27010033TW	多租戶應用程序的開發方法、資料存取方法與系統	中華民國	獲證	I490716	I490716	20150701	20321206	
11	19	P27010047	P27010047TW	自動配置伺服器及其用戶終端設備的	中華民國	獲證	I488473	I488473	20150611	20330101	

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
				管理方法							
	20	P27010047	P27010047US	自動配置伺服器及其用戶終端設備的管理方法	美國	獲證	9438469	9438469	20160906	20340902	
12	21	P27010072	P27010072TW	支援用戶端設備廣域管理協定之遠端管理系統及裝置及其提升遠端管理效能之方法	中華民國	獲證	I513230	I513230	20151211	20330428	V
	22	P27010072	P27010072US	支援用戶端設備廣域管理協定之遠端管理系統及裝置及其提升遠端管理效能之方法	美國	獲證	9960960	9960960	20180501	20341127	
13	23	P27020034	P27020034TW	連續性資料維護系統	中華民國	獲證	I501103	I501103	20150921	20340102	
14	24	P27020061	P27020061TW	交談式遠端管理系統及其負載平衡控制方法	中華民國	獲證	I568213	I568213	20170121	20340402	V
	25	P27020061	P27020061US	交談式遠端管理系統及其負載平衡控制方法	美國	獲證	9535775	9535775	20170103	20341213	V
15	26	P27030050	P27030050TW	路由封包以控制網路流量的方法及使用該方法的裝置	中華民國	獲證	I568290	I568290	20170121	20350318	
16	27	P27960037	P27960037TW	作業系統、物件儲存裝置與其資料存取方法	中華民國	獲證	I375886	I375886	20121101	20271126	
17	28	P27960049	P27960049FR	多協定單一介質網路傳輸方法與裝置	法國	獲證	2075982	EP2075982	20140604	20280330	
	29	P27960049	P27960049GB	多協定單一介質網路傳輸方法與裝置	英國	獲證	2075982	EP2075982	20140604	20280330	
18	30	P27960084	P27960084CN	虛擬文件管理系統及其系統配置建立與文件存取方法	中國大陸	獲證	CN101470735	ZL200710305559.5	20110504	20271226	
19	31	P27960085	P27960085TW	輔助記憶提醒方法與系統	中華民國	獲證	I357032	I357032	20120121	20271223	
20	32	P27960106	P27960106TW	社群網路系統及建立個人核心社群網、信任關聯網與社群系統通訊方法	中華民國	獲證	I418993	I418993	20131211	20280626	
21	33	P27970068	P27970068TW	資料收集之方法及其主動裝置與從動裝置	中華民國	獲證	I501608	I501608	20150921	20290122	
	34	P27970068	P27970068US	資料收集之方法及其主動裝置與從動裝置	美國	獲證	8139577	8139577	20120320	20291101	
22	35	P27970069	P27970069TW	偵測遠端序列埠設備之系統及其方法	中華民國	獲證	I474180	I474180	20150221	20281209	

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
23	36	P27970112	P27970112TW	自我照護提醒與警示通報之方法與裝置	中華民國	獲證	I484446	I484446	20150511	20281202	
24	37	P27980027	P27980027JP	肢段肌力與運動體適偵知系統及方法	日本	獲證	5005055	5005055	20120601	20300225	
	38	P27980027	P27980027TW	肢段肌力與運動體適偵知系統及方法	中華民國	獲證	I455705	I455705	20141011	20291006	V
	39	P27980027	P27980027US	肢段肌力與運動體適偵知系統及方法	美國	獲證	8246555	8246555	20120821	20301025	V
	40	P27980027	P27980027US D1	肢段肌力與運動體適偵知系統及方法	美國	獲證	8523741	8523741	20130903	20300128	
25	41	P27980048	P27980048TW	生理訊號感測模組	中華民國	獲證	I434673	I434673	20140421	20291115	
	42	P27980048	P27980048US	生理訊號感測模組	美國	獲證	8306597	8306597	20121106	20310512	
26	43	P27980094	P27980094TW	差動式電壓感測系統及其方法	中華民國	獲證	I408377	I408377	20130911	20300224	
	44	P27980094	P27980094US	差動式電壓感測系統及其方法	美國	獲證	8519792	8519792	20130827	20310214	
	45	P27980094	P27980094US D1	差動式電壓感測系統及其方法	美國	獲證	8442628	8442628	20130514	20300520	
27	46	P27990005	P27990005TW	健康管理系統及使用其之健康管理方法	中華民國	獲證	I421719	I421719	20140101	20300621	
28	47	P27990018	P27990018TW	隨身語能偵知方法及其裝置	中華民國	獲證	I403304	I403304	20130801	20300826	
	48	P27990018	P27990018US	隨身語能偵知方法及其裝置	美國	獲證	8712760	8712760	20140429	20320125	
29	49	P27990039	P27990039TW	頻寬分配方法及應用其之網路傳輸裝置	中華民國	獲證	I446753	I446753	20140721	20301228	V
30	50	P27990047	P27990047TW	家電待機狀態監控方法與裝置	中華民國	獲證	I407276	I407276	20130901	20301227	
	51	P27990047	P27990047US	家電待機狀態監控方法與裝置	美國	獲證	8570141	8570141	20131029	20320412	
31	52	P27990048	P27990048TW	網路傳輸裝置及其頻寬管理方法	中華民國	獲證	I497950	I497950	20150821	20310504	
	53	P27990048	P27990048US	網路傳輸裝置及其頻寬管理方法	美國	獲證	8879575	8879575	20141104	20320727	
32	54	P27990049	P27990049TW	聲音事件偵測模組及其方法	中華民國	獲證	I412019	I412019	20131011	20301202	
	55	P27990049	P27990049US	聲音事件偵測模組及其方法	美國	獲證	8655655	8655655	20140218	20320223	
33	56	P27990052	P27990052TW	肌動訊號輸入裝置、人機操作系統及其辨識方法	中華民國	獲證	I487505	I487505	20150611	20301216	
34	57	P27990102	P27990102TW	視訊會議系統及方法	中華民國	獲證	I448108	I448108	20140801	20310315	
35	58	P27990111	P27990111TW	具相對位置認知之控制系統及控制方	中華民國	獲證	I448927	I448927	20140811	20310623	

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
				法							
	59	P27990111	P27990111US	具相對位置認知之控制系統及控制方法	美國	獲證	8831752	8831752	20140909	20330311	

（二）雷射創新應用 10 案 12 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
36	60	P27000057	P27000057TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I453086	I453086	20140921	20311201	V
37	61	P27010021	P27010021TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I464952	I464952	20141211	20321002	V
38	62	P27010054	P27010054TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I496643	I496643	20150821	20321129	
39	63	P27010061	P27010061TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I517925	I517925	20160121	20321227	
40	64	P27010063	P27010063US	雷射創新應用	美國	獲證	9554839	9554839	20170131	20351110	
41	65	P27020030	P27020030TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I491921	I491921	20150711	20331110	
42	66	P27020052	P27020052TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I558489	I558489	20161121	20331126	
	67	P27020052	P27020052US	雷射創新應用	美國	獲證	9415464	9415464	20160816	20341228	
43	68	P27030027	P27030027CN	雷射創新應用	中國大陸	獲證	CN105789061	ZL201410814277.8	20190108	20341223	
	69	P27030027	P27030027TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I570056	I570056	20170211	20341210	V
44	70	P27040001	P27040001TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I594833	I594833	20170811	20350907	
45	71	P27040033	P27040033TW	雷射創新應用	中華民國	獲證	I570272	I570272	20170211	20360118	

（三）積層製造技術 6 案 14 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
46	72	P27020031	P27020031DE	粉體成型方法及其裝置	德國	獲證	EP2871042	EP2871042	20170809	20331217	
	73	P27020031	P27020031FR	粉體成型方法及其裝置	法國	獲證	EP2871042	EP2871042	20170809	20331217	
	74	P27020031	P27020031GB	粉體成型方法及其裝置	英國	獲證	EP2871042	EP2871042	20170809	20331217	
	75	P27020031	P27020031TW	粉體成型方法及其裝置	中華民國	獲證	I624350	I624350	20180521	20331107	
	76	P27020031	P27020031US	粉體成型方法及其裝置	美國	獲證	9457517	9457517	20161004	20341211	V

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
47	77	P27030016	P27030016CN	多噴頭打印裝置	中國大陸	獲證	CN105538906	ZL201410634877.6	20170524	20341111	V
	78	P27030016	P27030016TW	雙噴頭列印裝置	中華民國	獲證	I574847	I574847	20170321	20341028	V
48	79	P27030024	P27030024TW	醫療用複合材料及其製作方法與應用	中華民國	獲證	I548429	I548429	20160911	20341106	V
	80	P27030024	P27030024US	醫療用複合材料及其製作方法與應用	美國	獲證	10463500	10463500	20191105	20360412	V
49	81	P27040037	P27040037TW	積層製造方法	中華民國	獲證	I601629	I601629	20171011	20360411	
50	82	P70050014	P70050014CN	三維打印供料裝置與可變孔口裝置	中國大陸	獲證	CN108145964	ZL201710003825.2	20201030	20370103	
	83	P70050014	P70050014TW	三維列印供料裝置與可變孔口裝置	中華民國	獲證	I602765	I602765	20171021	20361201	
	84	P70050014	P70050014TWD1	可變孔口裝置	中華民國	獲證	I654070	I654070	20190321	20361201	
51	85	P70060009	P70060009TW	用於熱交換器的流道結構	中華民國	獲證	I638129	I638129	20181011	20371128	

（四）軟性製造技術 2 案 5 件。

案次	件次	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
52	86	P27010015	P27010015CN	貼合裝置及包含該貼合裝置的設備	中國大陸	獲證	CN103660506	ZL201210369192.4	20160323	20320926	
	87	P27010015	P27010015TW	貼合裝置及含其之設備	中華民國	獲證	I491504	I491504	20150711	20320920	
	88	P27010015	P27010015US	貼合裝置及含其之設備	美國	獲證	9321252	9321252	20160426	20340701	
53	89	P70080015	P70080015TW	電致變色元件製造方法	中華民國	獲證	I430005	I430005	20140311	20311123	V
	90	P70080015	P70080015US	電致變色元件製造方法	美國	獲證	8992719	8992719	20150331	20331016	V

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。